

2025年3月期
決算説明資料

2025年5月19日
内外テック株式会社
(証券コード 3374)



2025年3月期
決算ハイライト

本日のポイント

POINT

1

2025年3月期実績

顧客の在庫調整の影響により、減収増益

売上高 **35,337**百万円
(前期比▲9.4%)

営業利益 **1,552**百万円
(前期比27.4%)

親会社株主に帰属する当期純利益 **1,049**百万円
(前期比23.7%)

POINT

2

2026年3月期予想

今後の成長を見据えた人員増強のための先行費用が増加し減益予想

売上高 **35,500**百万円
(前期比0.5%)

営業利益 **1,230**百万円
(前期比▲20.8%)

親会社株主に帰属する当期純利益 **640**百万円
(前期比▲39.0%)

POINT

3

中期経営計画「MIRAI2026」の経営指標を下方修正

世界経済環境の変化及び半導体市場の回復の遅れによる外部環境の変化

2027年3月期（最終年度）

売上高 **44,800**百万円

営業利益 **1,810**百万円

自己資本比率 **45%**

ROE **9%**



2025年3月期
連結業績・事業概況

2025年3月期 業績（2024年4月～2025年3月）

- ・ 期初の想定より回復が遅れたことにより、2月に下方修正
- ・ 前期比では減収になるも、原価率が改善し増益に寄与

決算実績

(百万円)	2024年3月期			2025年3月期				
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比	修正予想 (2月14日公表)	期初予想 (5月15日公表)
売上高	39,013	▲13.8%	100.0	35,337	▲9.4%	100.0	35,600	43,800
売上原価	34,964	▲12.9%	89.6	30,717	▲12.1%	86.9	—	—
販管費	2,830	0.7%	7.3	3,068	8.4%	8.7	—	—
営業利益	1,218	▲48.1%	3.1	1,552	27.4%	4.4	1,480	1,540
経常利益	1,189	▲49.1%	3.0	1,525	28.3%	4.3	1,450	1,520
親会社株主に帰属する 当期純利益	848	▲48.2%	2.2	1,049	23.7%	3.0	960	1,030

売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

- ・下期から回復するも、通期では減収
- ・受託製造事業が下支えし増益

売上高

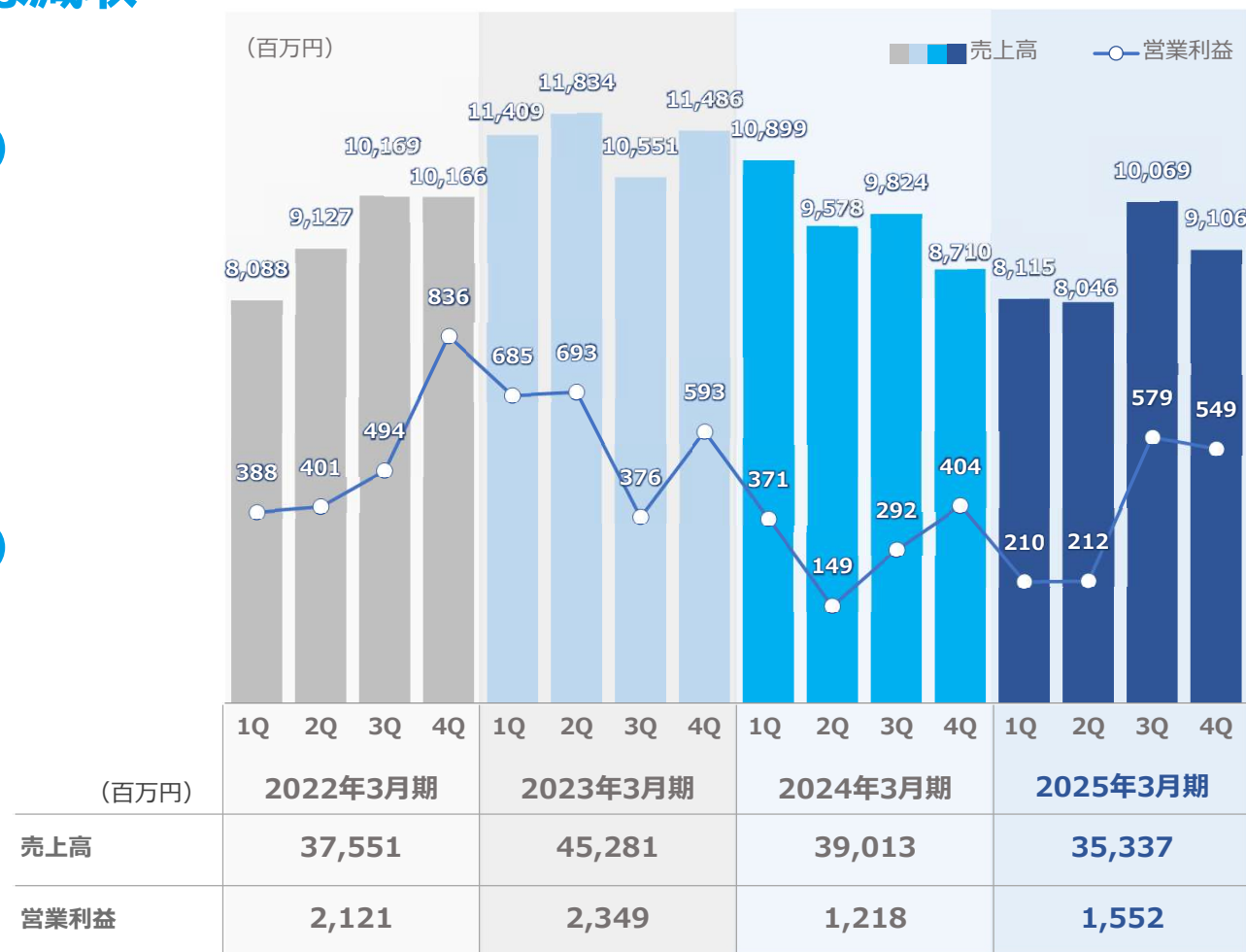
35,337百万円（前期比▲9.4%）

- 下期より回復するも、回復力が弱く上期の減収の影響を受け減収
- 市場回復が見られるも、顧客の在庫調整から受注の回復が遅延

営業利益

1,552百万円（前期比27.4%）

- 上期は低迷するも、下期は売上増加に伴い回復
- 利益率改善により売上高が減少するも増益



売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

・売上総利益率は大幅に改善

売上総利益率

13.1%（前期比+2.7ポイント）

- 販売価格の見直しが進み、売上総利益率は改善
- 4Qは仕入先からの販売報奨金により大幅に上昇

販売管理費

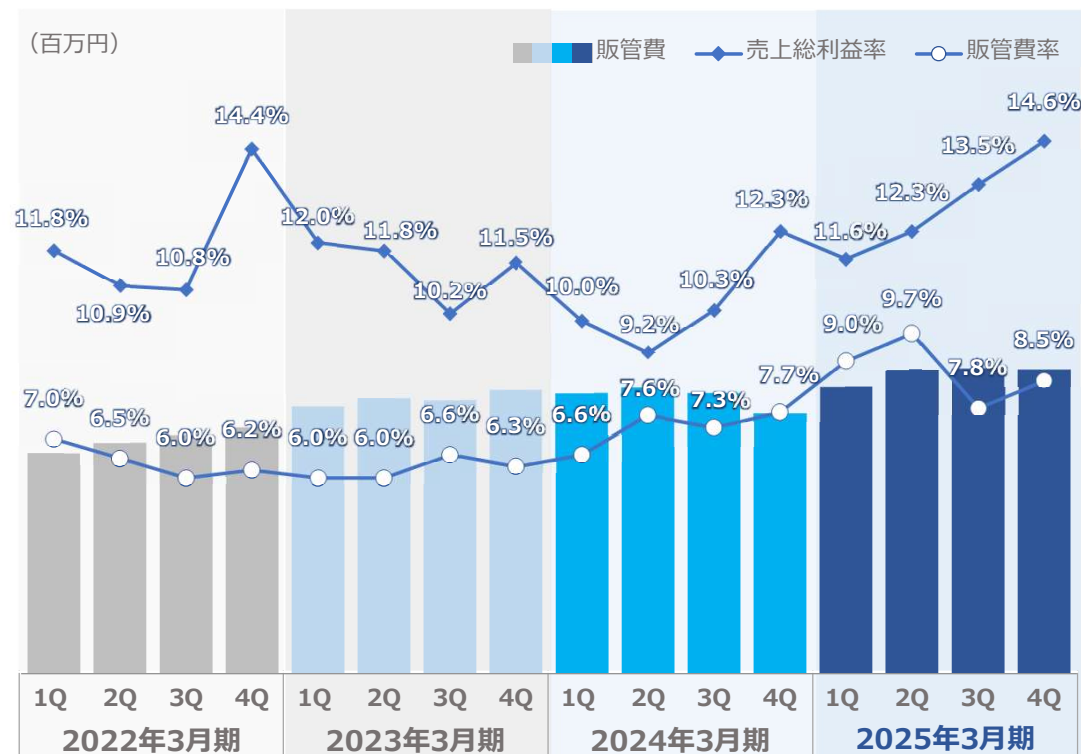
3,068百万円（前期比+8.4%）

- 業務改善を進めるも人件費や減価償却費、拠点拡大による地代家賃等の費用が増加

販売管理費率

8.7%（前期比+1.4ポイント）

- 費用増加に加え減収により、販管費率は上昇



	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	2022年3月期				2023年3月期				2024年3月期				2025年3月期			
売上総利益率	11.8%	10.9%	10.8%	14.4%	12.0%	11.8%	10.2%	11.5%	10.0%	9.2%	10.3%	12.3%	11.6%	12.3%	13.5%	14.6%
販管費	7.0%	6.5%	6.0%	6.2%	6.0%	6.0%	6.6%	6.3%	6.6%	7.6%	7.3%	7.7%	9.0%	9.7%	7.8%	8.5%
販管費率	5.8%	5.9%	5.5%	4.3%	5.2%	5.1%	6.4%	5.5%	6.6%	8.2%	7.1%	6.3%	7.8%	8.0%	5.8%	6.1%

セグメント別概況 販売事業

・下期から改善するも、減収減益に

セグメント売上高

31,300百万円（前期比▲12.5%）

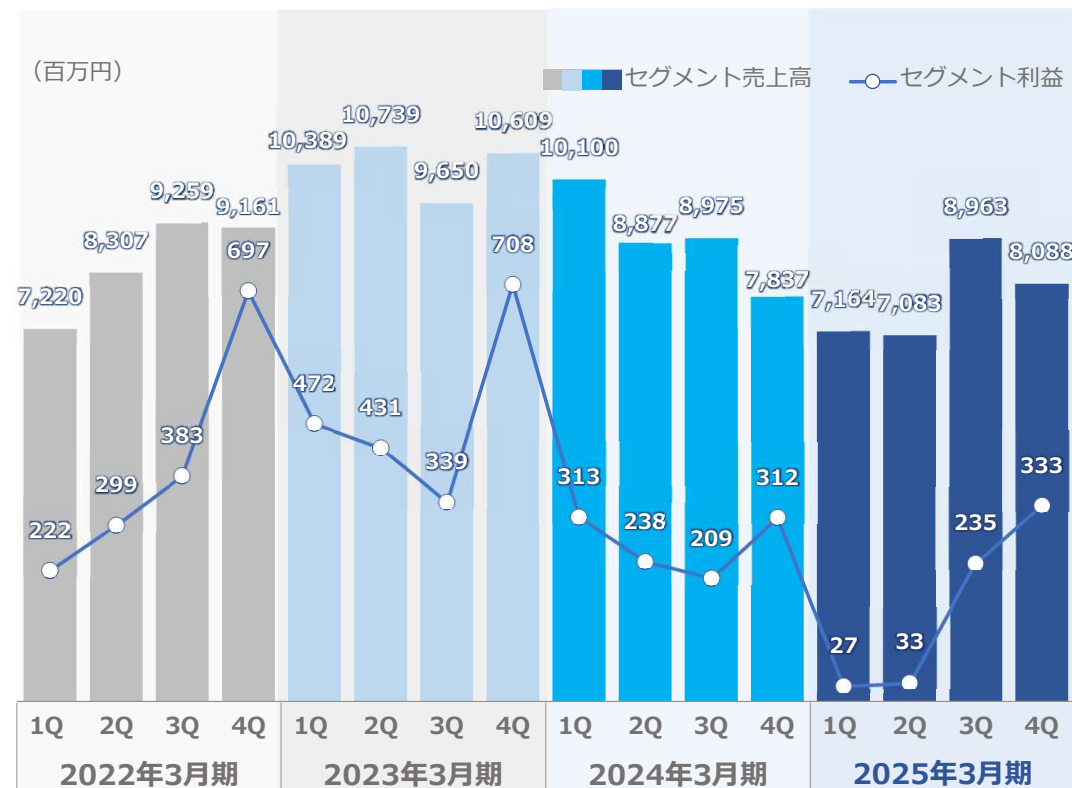
- 前期から続く顧客の在庫調整等による影響から上期まで低迷、下期に受注が改善するも、通期では減収

セグメント利益

630百万円（前期比▲41.2%）

- 売上高減少に伴い売上総利益が減少
- 営業強化・品質強化のための社員採用に係る費用が増加
- グループ内物流センター統合や、今後の成長を見据えた物流スキーム変更に伴い、費用が増加

（注）セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております



	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	2022年3月期				2023年3月期				2024年3月期				2025年3月期			
セグメント売上高	33,950				41,388				35,791				31,300			
セグメント利益	1,602				1,951				1,072				630			
セグメント利益率	4.7%				4.7%				3.0%				2.0%			

セグメント別概況 受託製造事業

・主要顧客からの受注が増加し増収、利益は大幅に改善

セグメント売上高

6,267百万円 (前期比+12.1%)

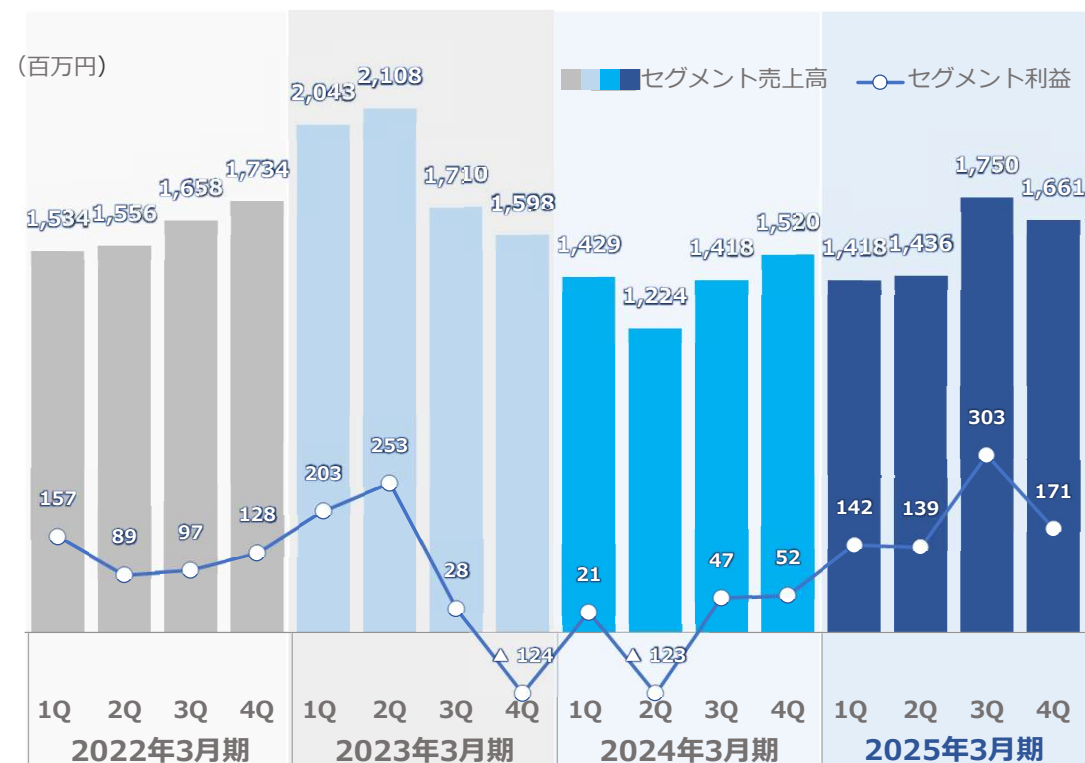
- 半導体市場の回復を受けて主要顧客からの受注が増加
- 当期より実施のグループ効率化推進策（資材調達／物流統合）に伴い純額表示（会計処理）を実施。
実質売上では過去最高を更新。

セグメント利益

755百万円 (前期比 —)

- 受注回復及び生産効率改善により大幅に増益
- 仕入売上のスキーム変更により原材料費率が低減
- グループ内物流センター統合による固定費が減少

(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、
連結調整前の数値となっております

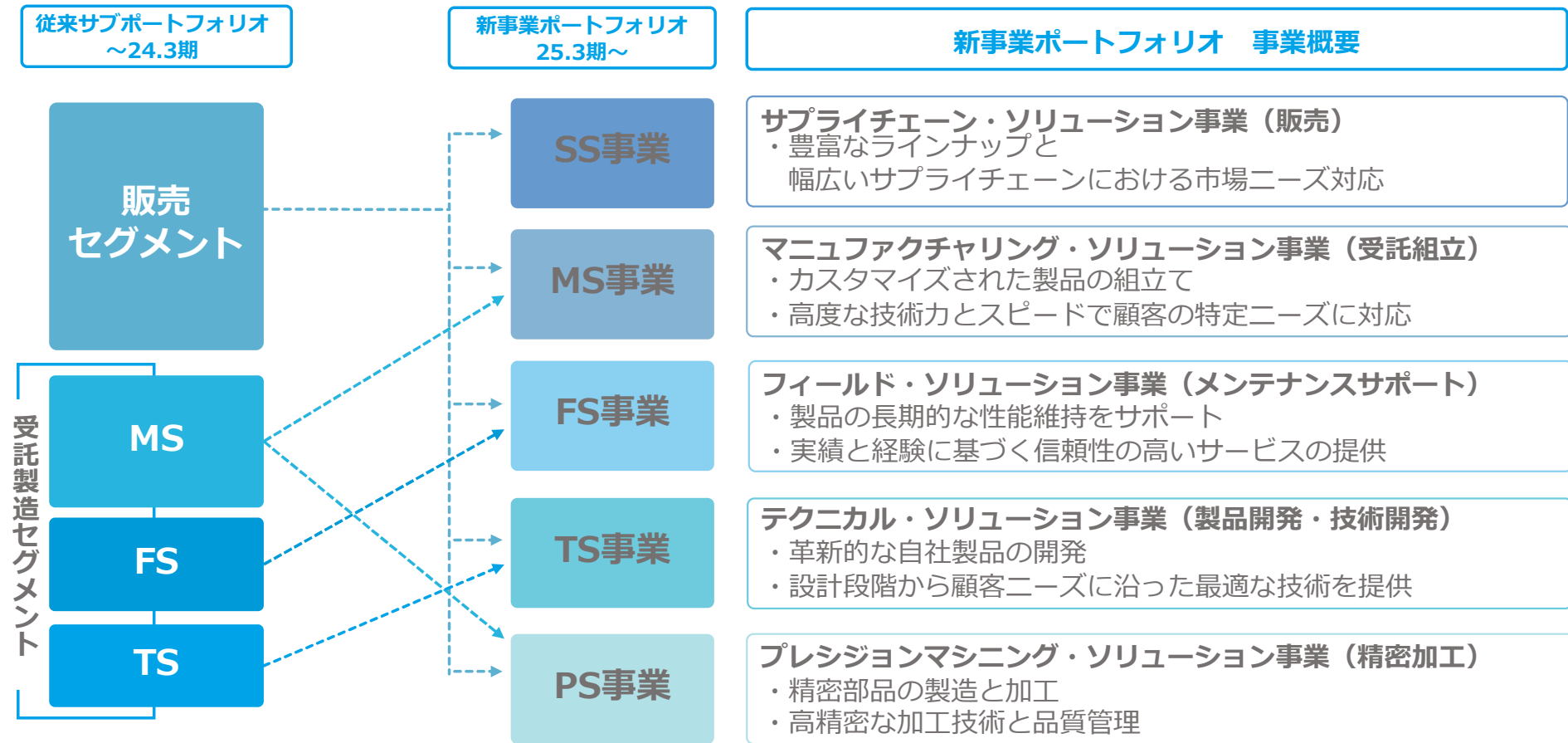


(百万円)	1Q	2Q	3Q	4Q	2022年3月期	1Q	2Q	3Q	4Q	2023年3月期	1Q	2Q	3Q	4Q	2024年3月期	1Q	2Q	3Q	4Q	2025年3月期
セグメント売上高					6,483					7,460					5,592					6,267
セグメント利益					473					361					▲2					755
セグメント利益率					7.3%					4.8%					-					12.1%

事業ポートフォリオ概要

- ・ 資本の最適配分を目指し、事業ポートフォリオを見直し

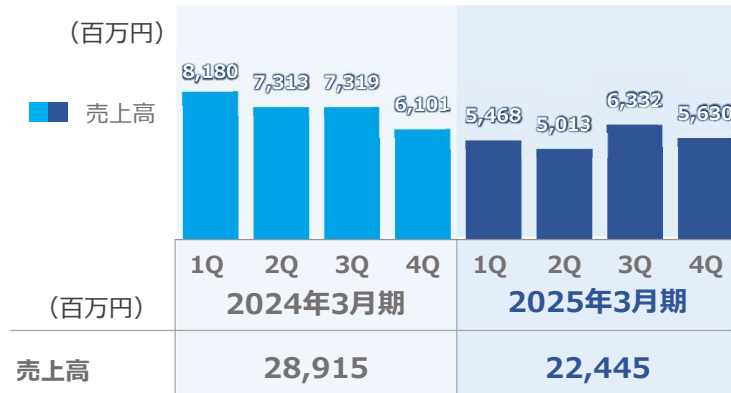
事業ポートフォリオの概要



事業ポートフォリオ別概況

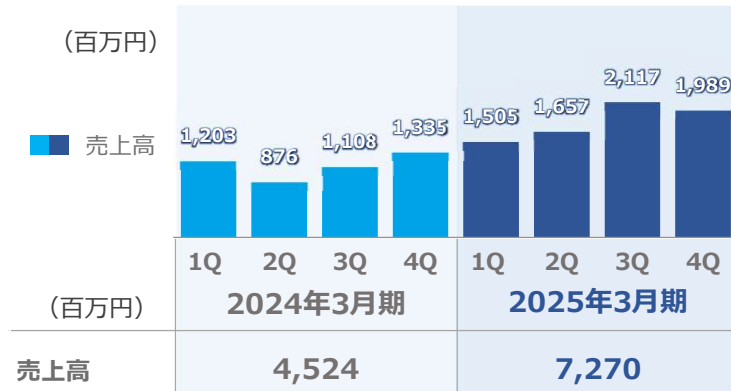
サプライチェーン・ソリューション事業

- 顧客の在庫調整の影響を受け、減収

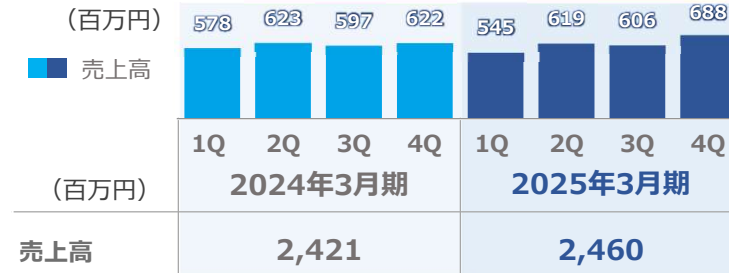


マニファクチャリング・ソリューション事業

- 前2Q以降、受注増加傾向が継続し大幅な増収

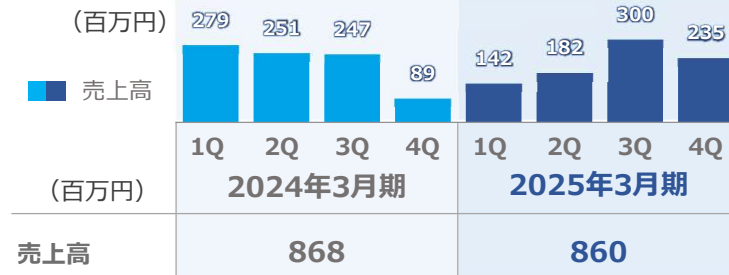


フィールド・ソリューション事業



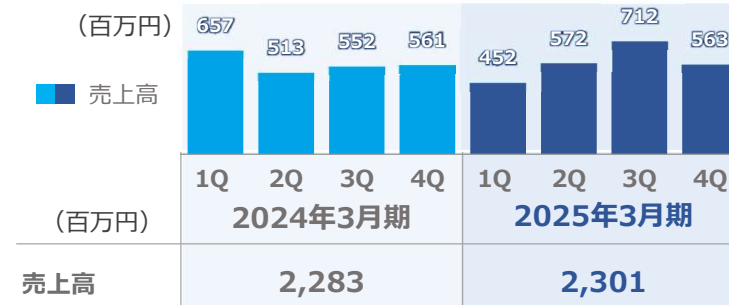
- 顧客の生産調整による修理・メンテナンス事業の受注が減少するも、フィールドエンジニア増員によるフィールド事業の売上が寄与し前期並みに

テクニカル・ソリューション事業



- 上期は顧客からの受注が減少するも、下期にスポット受注が増加

プレジジョンマシニング・ソリューション事業



- 在庫調整の影響により一部製品が低迷するも、他製品が下支え

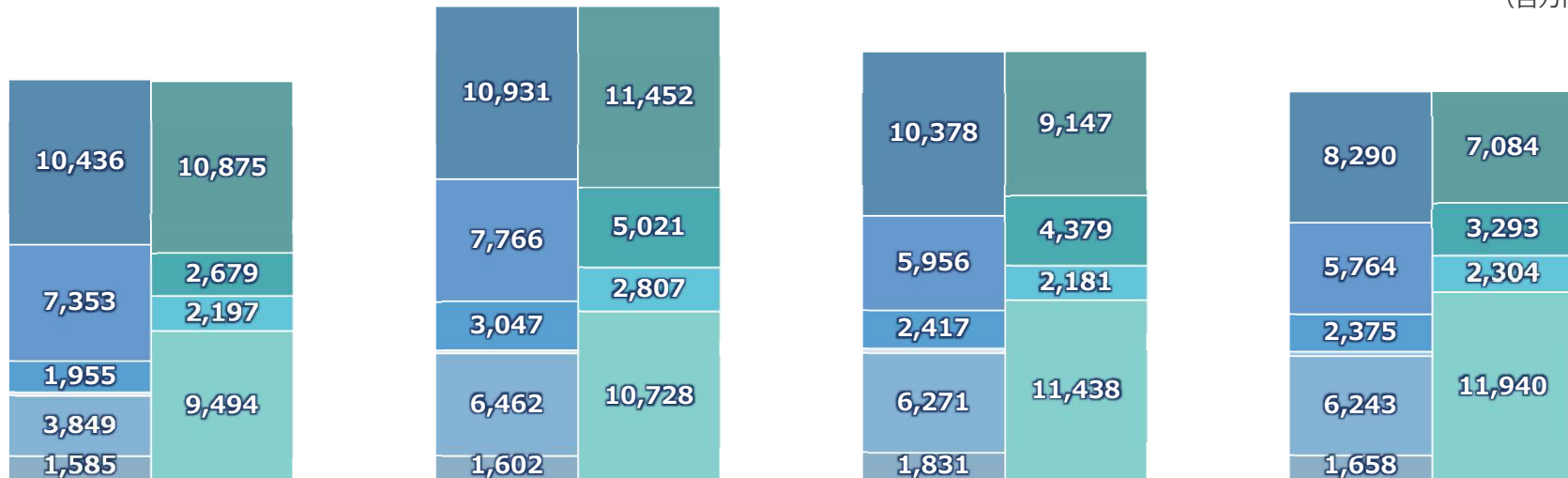
連結貸借対照表

- ・売上高減少のほか、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨を鑑み支払サイトを短縮したことにより、買掛債務及び現預金は減少
- ・総資産の圧縮により、自己資本比率は改善

連結貸借対照表

(百万円)

■ 現金・預金
 ■ 売上債権
 ■ 棚卸資産
 ■ その他流動資産
 ■ 有形固定資産
 ■ その他固定資産
 ■ 買入債務
 ■ 有利子負債
 ■ その他負債
 ■ 純資産



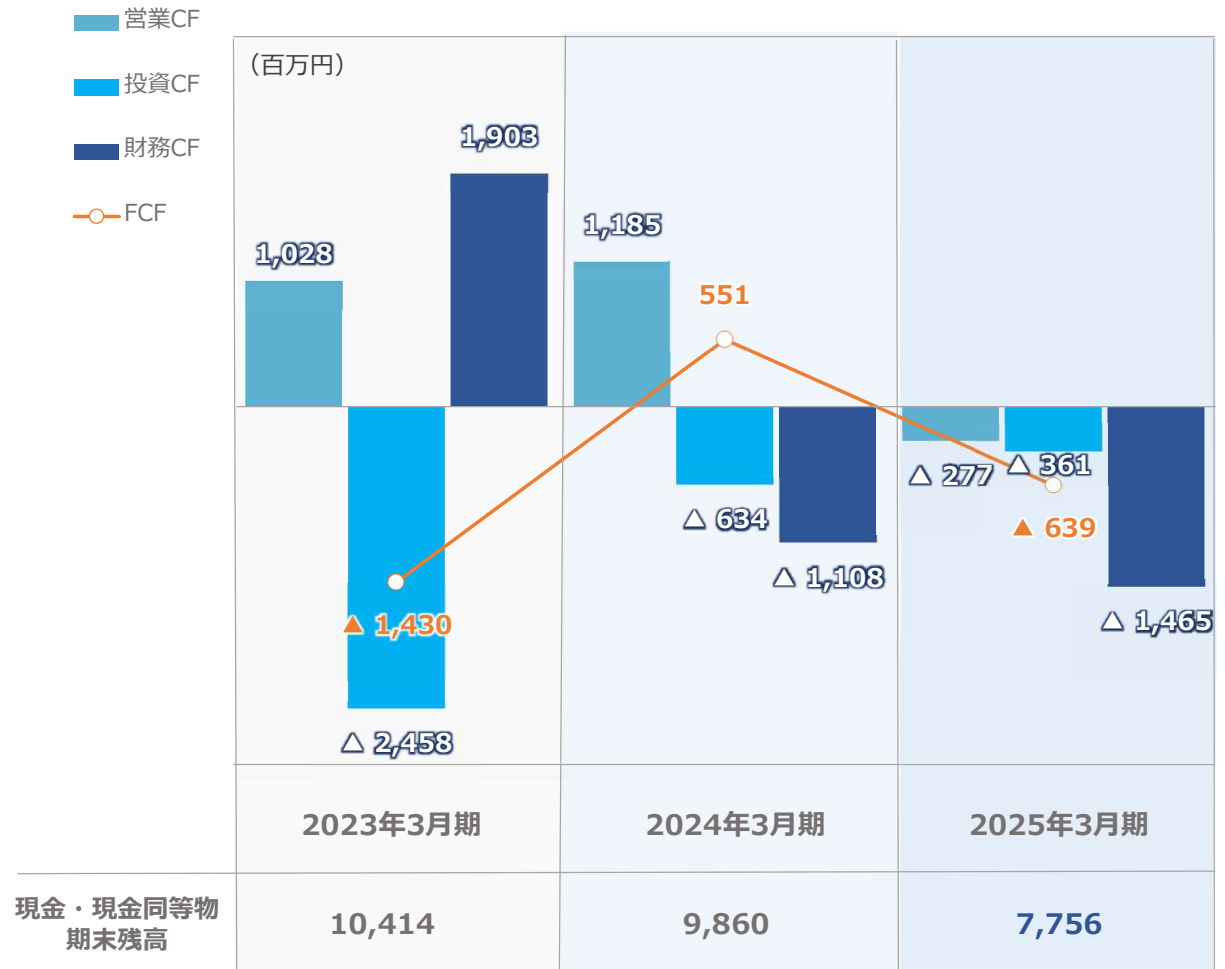
(百万円)	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
純資産	9,494	10,728	11,438	11,940
自己資本比率	37.6%	35.7%	42.1%	48.5%

連結キャッシュフロー

・営業キャッシュフロー赤字により、現金・現金同等物期末残高は減少

キャッシュフロー計算書

- 売上高の減少・支払いサイトの短縮により、営業キャッシュフローはマイナス
- 23年3月期にて当面の設備増強が完了し、投資キャッシュフローは減少
- 大型投資の終了に伴い新規の資金調達はなく、既存借入金の返済等で財務キャッシュフローはマイナス



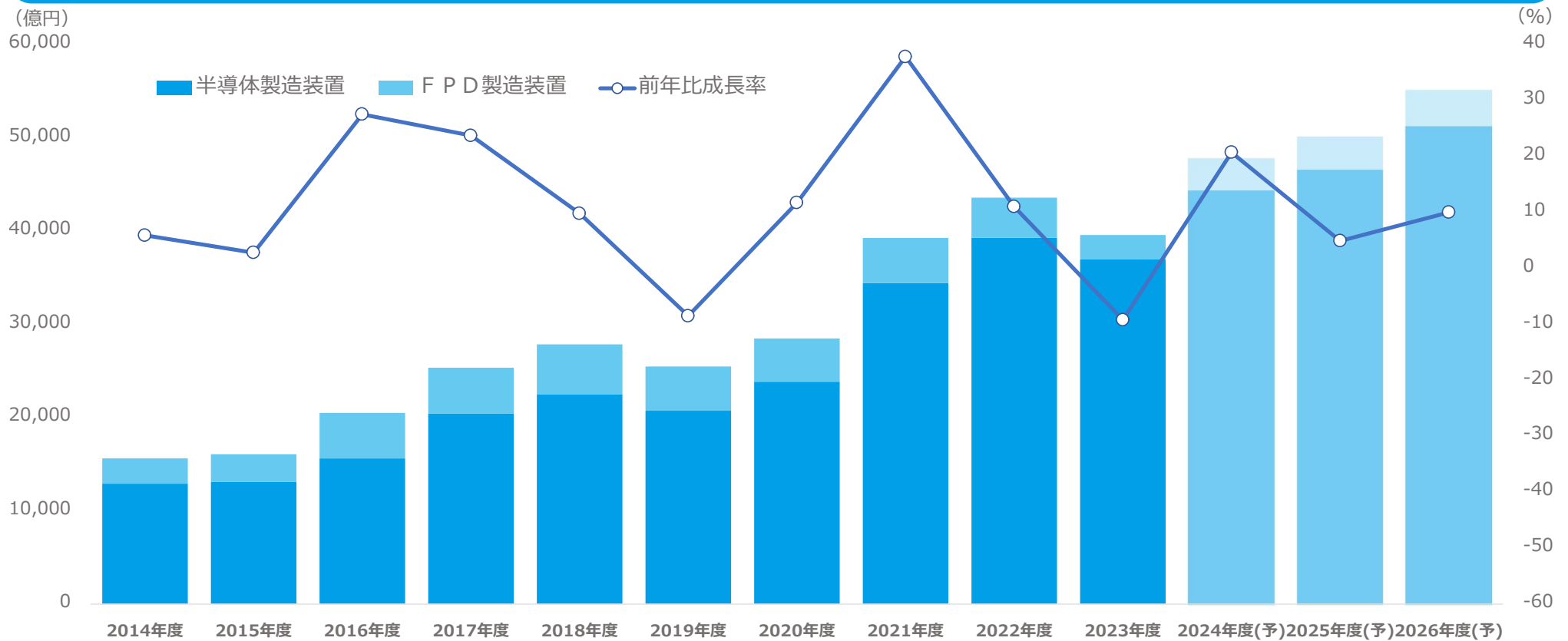


2026年3月期
連結業績予想

半導体製造装置市場動向

- ・ A I 関連半導体の需要が牽引し、中長期的に拡大傾向

半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



出所：SEAJ 2025年1月16日発表資料を基に当社にて作成

2026年3月期 通期連結業績予想

- ・ 足元のPCやスマートフォン、車載や産業機械向け半導体需要の減退を鑑み、売上高は前期並みの予想
- ・ 今後の増産対応に備えた増員、成長戦略に基づく開発等の先行費用が増加し収益は減益を予想

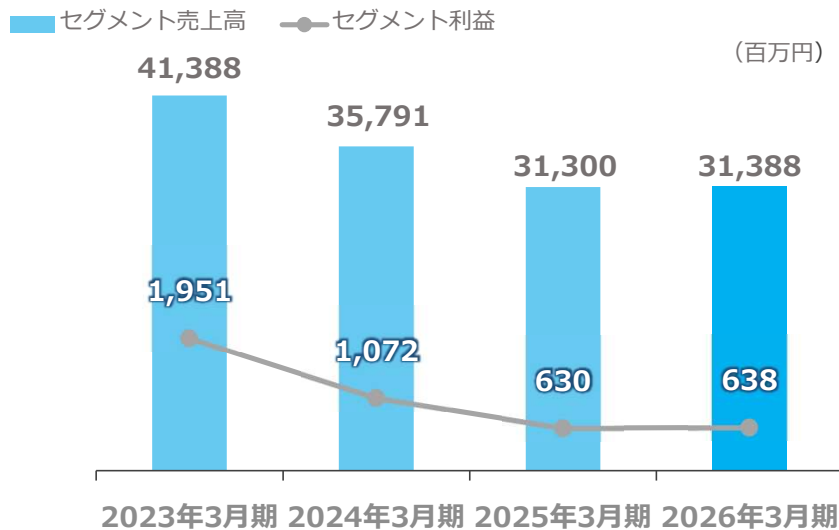
(百万円)	2025年3月期			2026年3月期				
	通期			通期			中間	
	実績	前期比	構成比	通期予想	前期比	構成比	中間予想	前年同期比
売上高	35,337	▲9.4%	100.0	35,500	0.5%	100.0	15,780	▲2.4%
営業利益	1,552	27.4%	4.4	1,230	▲20.8%	3.5	254	▲40.0%
経常利益	1,525	28.3%	4.3	1,190	▲22.0%	3.4	238	▲41.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,049	23.7%	3.0	640	▲39.0%	1.8	46	▲81.8%
1株当たり配当金	100.0円	—	—	102.0円	—	—	—	—
設備投資額	368	—	—	—	—	—	—	—
減価償却費	396	—	—	319	—	—	—	—

セグメント別業績予想

- ・セグメント売上高は、販売・受託製造事業ともに前期並みの予想
- ・受託製造のセグメント利益は、今後の成長に備えた費用増により減益見込み

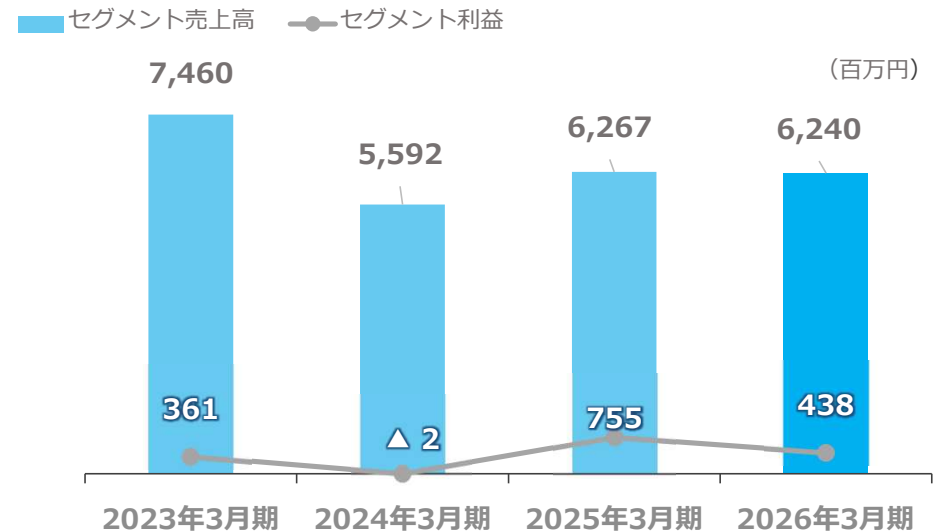
販売事業

- A I サーバー向け半導体は増加を見込むも、車載や産業機械向けは鈍化の予想
- セグメント売上・セグメント利益ともに前期並み見込む



受託製造事業

- 前期並みの受注見込み
- 今後の増産対応に備えた増員計画のため減収予想



(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

事業ポートフォリオ別業績予想

・技術領域に注力し、フィールド及びテクニカル・ソリューション事業を強化

サプライチェーン・ソリューション事業

(百万円)



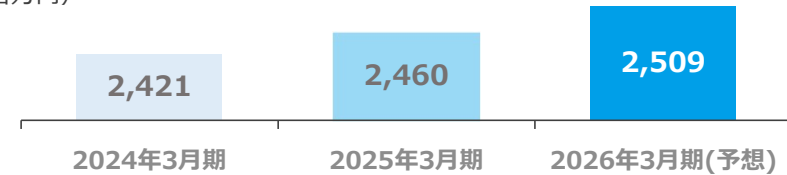
マニュファクチャリング・ソリューション事業

(百万円)



フィールド・ソリューション事業

(百万円)



テクニカル・ソリューション事業

(百万円)



プレジジョンマシニング・ソリューション事業

(百万円)

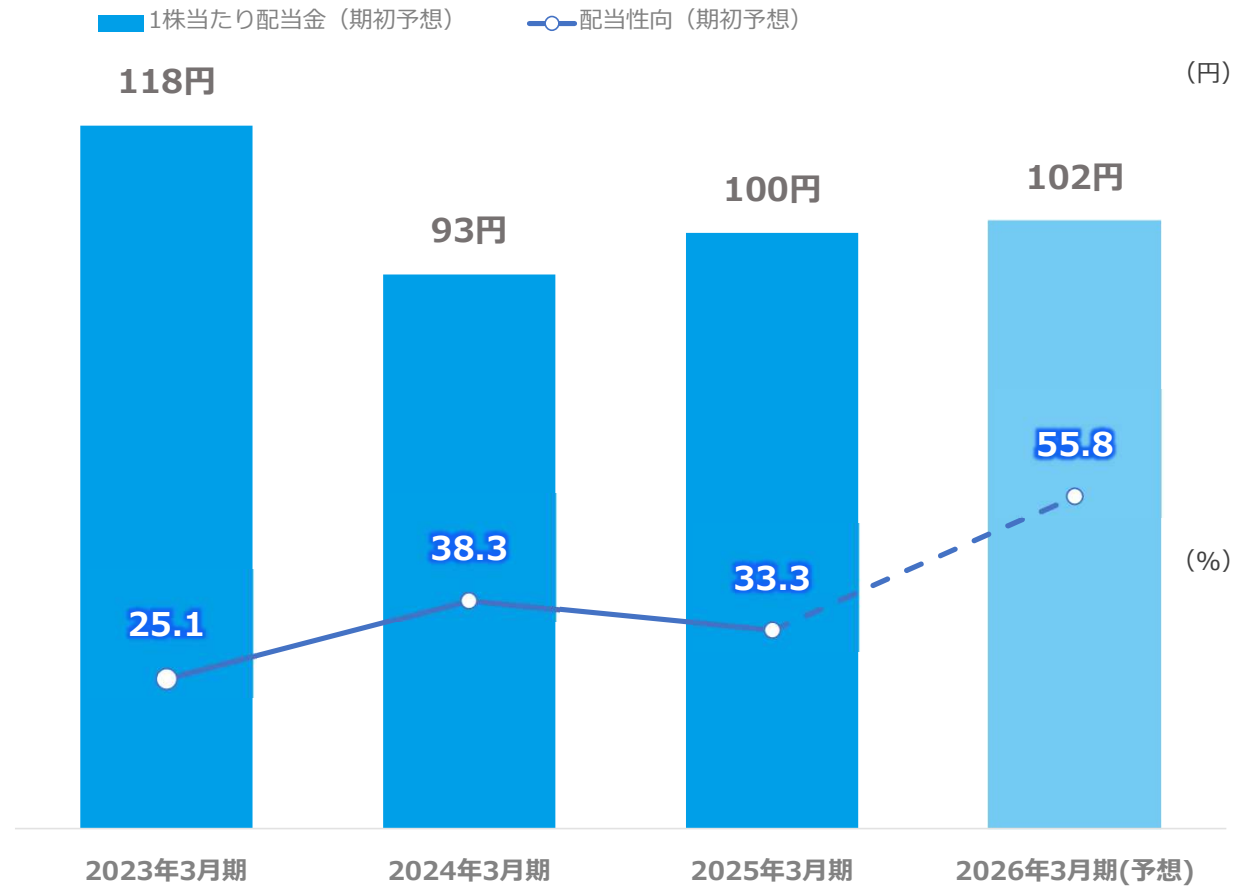


配当政策

- ・ 今後の成長のための投資と株主様への還元のバランスを考慮しつつ、企業価値向上を目指す

基本方針

- 連結配当性向 **30%** 以上かつ
連結株主資本配当率（DOE） **3%** 以上を
目標とし、業績に応じた配当を継続していく



サステナビリティ目標

- ・中期経営計画「MIRAI2026」重点戦略に基づき「サステナビリティ目標」を推進。前期の達成率は75%（6/8項目）

ミッション	マテリアリティ	サステナビリティ目標	サステナビリティKPI	2025年 3月期			2026年 3月期	単位
				KPI目標	実績	評価	KPI目標	
Market creation : 新市場の創造	新市場創造戦略	未開拓市場(新市場・新製品)への進出	開発製品 (自社・共同開発)	0	0	○	0	件
Innovation : 技術革新	エンジニア	メンテナンスサポート分野の 技術者増員と、人材育成システムの強化	エンジニアの充足率	100.0	104.2	○	100.0	%
Resilience : 変化への柔軟な対応	ガバナンス強化	社外取締役の比率、 及び女性取締役の選任	ガバナンス体制の強化	34.0	42.9	○	34.0	%
				1	1	○	1	人
	エンゲージメント向上	働きがい、働きやすさの向上と 多様性の確保	女性管理職比率	8.0	9.5	○	9.0	%
	環境対応	CO ₂ 削減（2022年度対比）	2030年目標70%減、 2040年NetZero	-	▲23.1 (増加)	-	12.0	%
Alliance : サプライチェーンの連携	共同研究開発	他社との協議による 新製品・新技術の研究開発	共同開発による開発件数	2	1	▲	3	件
Integration : 価値の統合	サプライチェーンと バリューチェーンの統合	サプライチェーン1,500社と、 当社のバリューチェーンの統合により、 市場に新たな価値を提供	営業利益率	3.6	4.4	○	3.5	%
資本政策	資本コストを意識した経営	企業価値向上	PBR1倍以上	≥1.0	0.65	▲	≥1.0	倍

※ 評価：○＝達成 ▲＝未達成



中期経営計画
MIRAI 2026進捗

MIRAI 2026 目指す経営指標

- ・中長期的にはA I 向け半導体を中心に市場の拡大が見込まれますが、車載や産業機械向け半導体の回復の遅れや半導体関連投資状況の変更等、市場の変化により、当面の成長の伸び率は弱いものと想定

2026年度（最終年度）目標

修正前

売上高

600億円

営業利益

30億円

自己資本比率

43%

ROE

14%



修正後

売上高

448億円

営業利益

18億円

自己資本比率

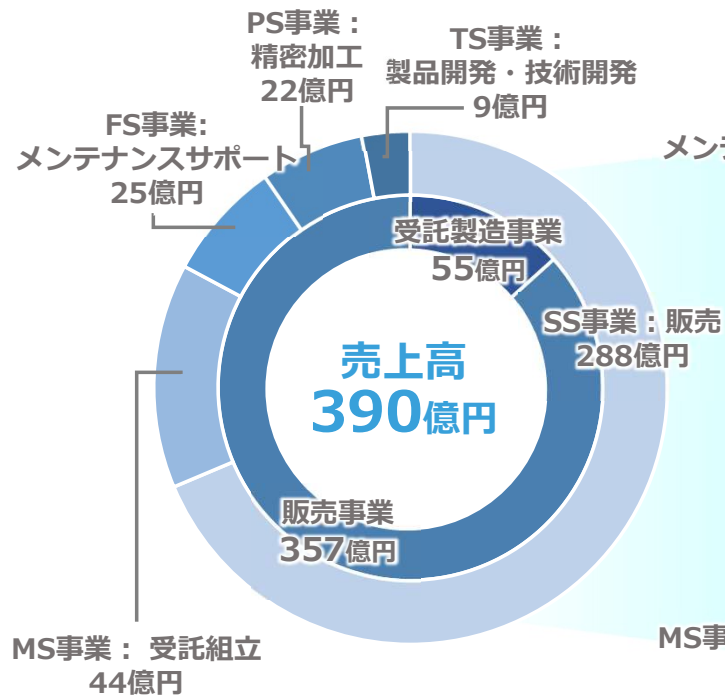
45%

ROE

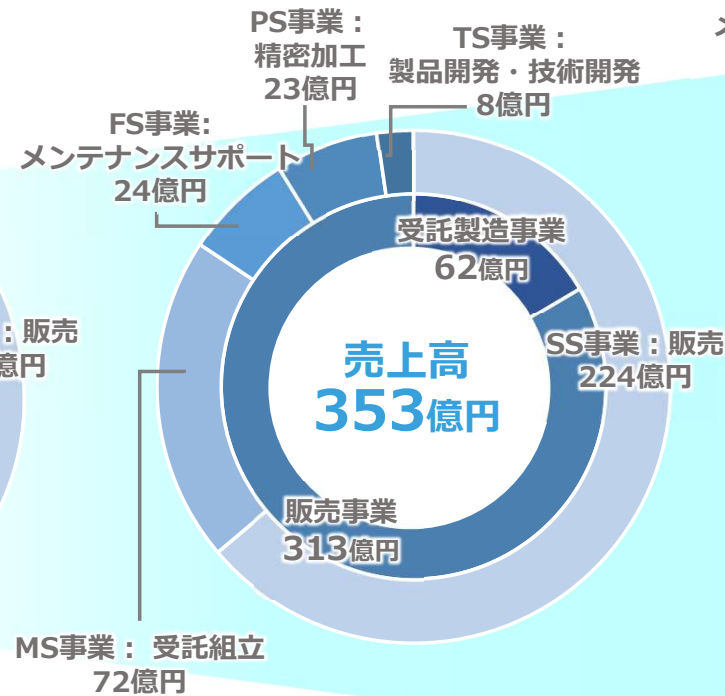
9%

セグメントと事業ポートフォリオの推移

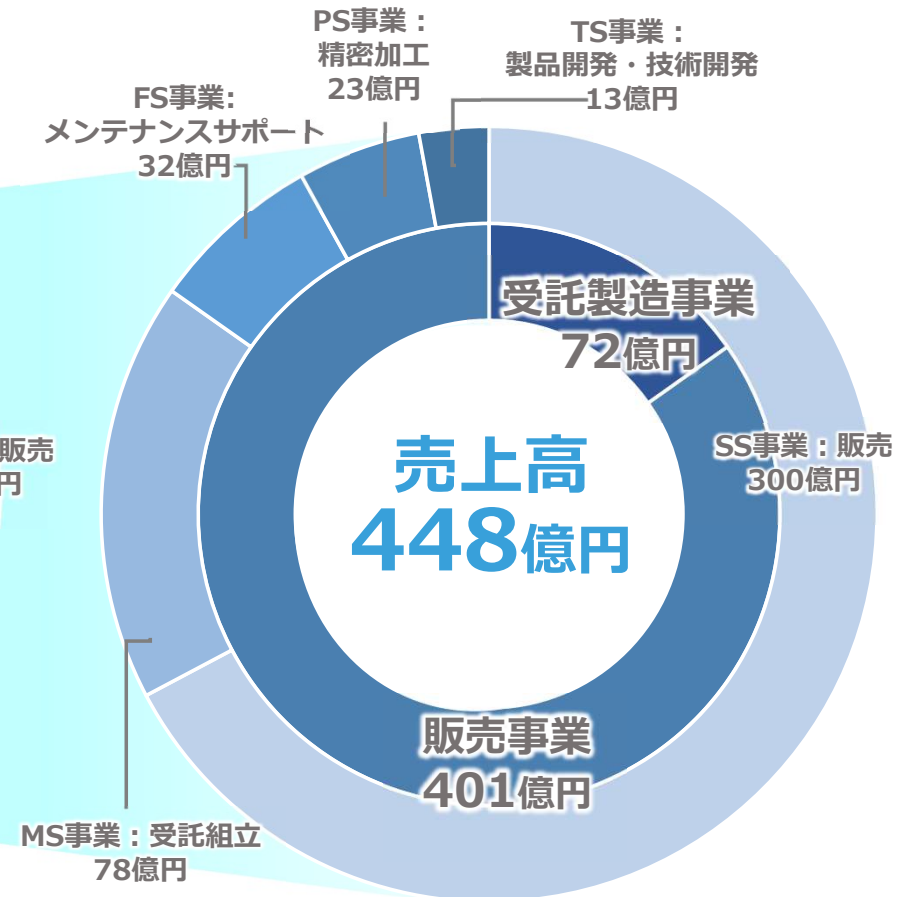
2023年度



2024年度



2026年度



(注) 2026年度（最終年度）のセグメント及び事業ポート売上高を修正しております



参考資料

参考資料 会社概要

本社所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、 受託製造が2本柱
従業員数	連結 671名（2025年3月末）
連結子会社	内外エレクトロニクス株式会社 納宜伽義機材（上海）商貿有限公司



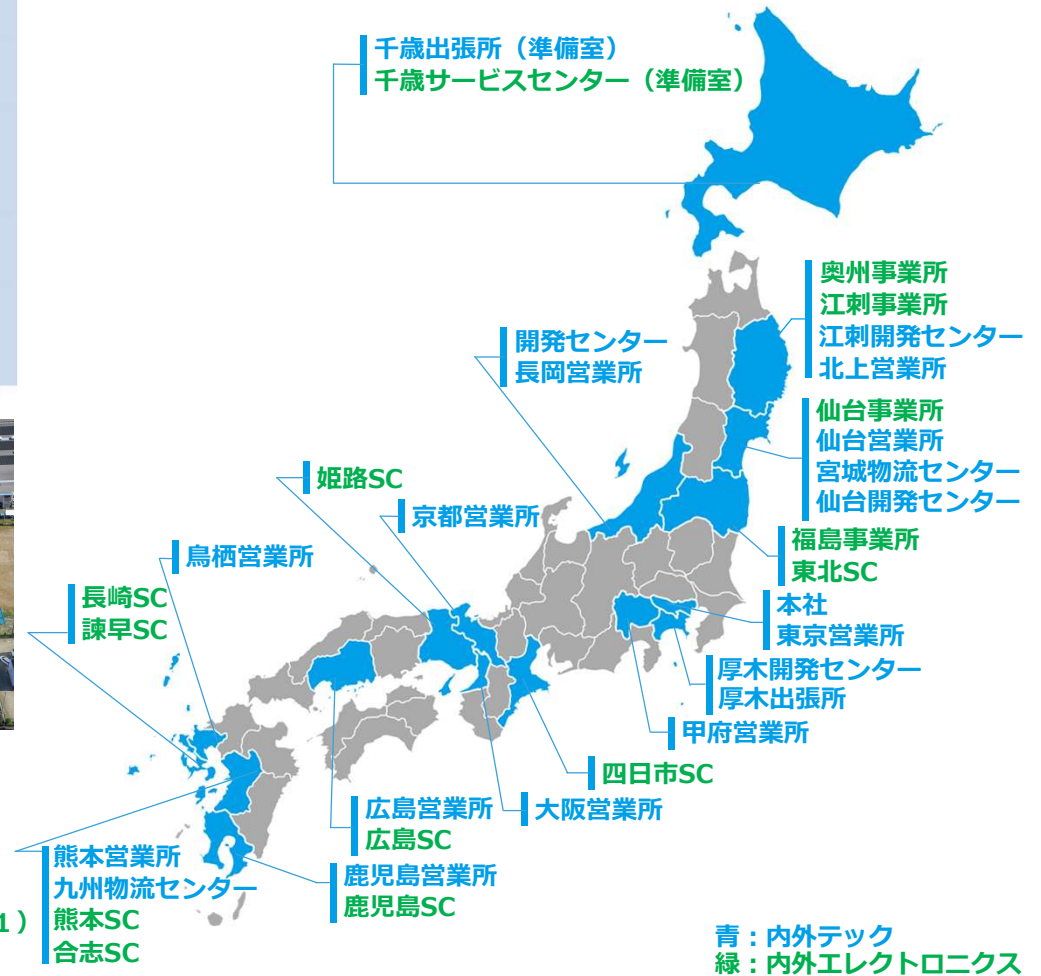
本社・東京営業所

納宜伽義機材（上海）
商貿有限公司

仙台事業所

国内 **35** 拠点
海外 **2** 拠点

内外テック **20** 拠点（今期新拠点+3）
 内外エレクトロニクス **15** 拠点（今期新拠点+1）
 内外機材（上海） **2** 拠点



参考資料 当社グループの主力ビジネス

半導体製造工程概要



内外テック
技術提案商社



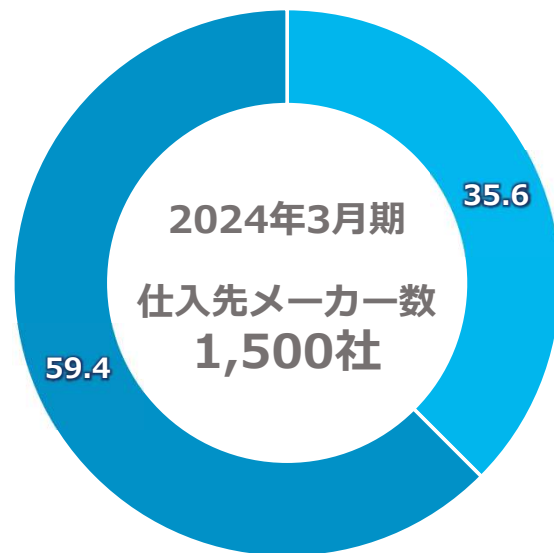
内外エレクトロニクス
受託製造メーカー



モノづくりができるメーカー商社

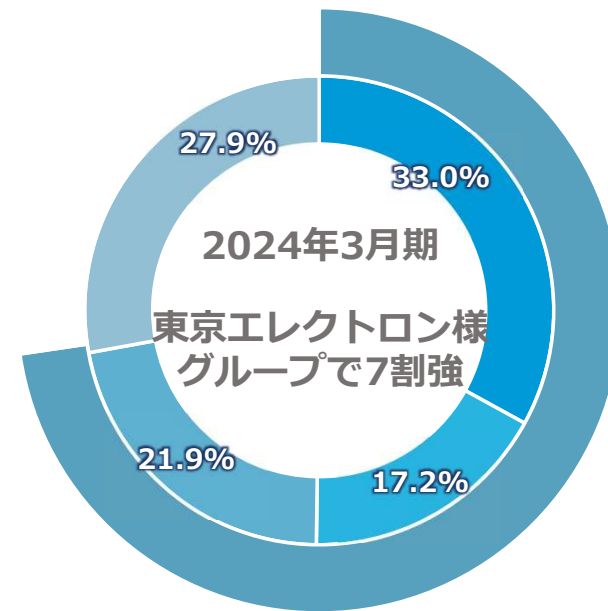
参考資料 当社の仕入先・販売先

仕入先



■ 空気圧機器メーカー ■ その他メーカー

販売先



■ 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社様
 ■ 東京エレクトロン宮城株式会社様 ■ 半導体・液晶・電子部品各社
 ■ 東京エレクトロン九州株式会社様

内外テック 仕入先・販売先

仕入先メーカー数 約 1,500件
 得意先数 約 900件
 年間取扱いアイテム 約 52,500件

主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、メンテナンスサポート、装置改造

NaigaiTEC Corporation

- ・本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません
- ・本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません
- ・銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします

内外テック株式会社

<https://www.naigaitec.co.jp>

スタンダード : 3374